证券代码：301583　　证券简称：托伦斯

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	东北证券　广发证券 国联民生　国泰海通 华创证券　华福证券 天风证券
时间	2026 年 11 月 19 日 14：00-15：00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理兼首席执行官：钱珂先生 董事、首席财务官兼董事会秘书：许红艳女士 证券事务代表：姜威先生 投资高级专员：刘启扬先生
投资者关系活动主要内容介绍	**交流环节主要内容如下：** **1、根据测算，中国半导体零部件的市场规模超 1000 亿，公司的产能布局及未来的份额规划？** 答：公司在持续加快推进产能扩充，同步加快募投项目建设，新增了募投项目实施地点。公司希望加快满足客户的需求，持续扩充产能，提升产品的竞争力，来提升份额占比。 **2、公司不同品类毛利率水平？驱动毛利率变化的核心变量是产品结构升级、良率、规模效应还是价格降价？** 答：关键工艺零部件的毛利率相对高一些，因为技术含量高，产

	品复杂度高。目前看驱动毛利率变动最大的因素就是规模效应，从去年下半年到今年公司仍在不断扩产中。扩产期间的资本开支、设备折旧、人力成本等支出对毛利率的影响很大。 **3、公司三季度报告毛利率有所下滑的原因？后续公司毛利率是否会回升？** 答：由于公司从去年下半年开始不断地持续扩产，土地建设、厂房装修、设备投资、人员扩充以及新品的爬坡，阶段性的毛利率会有承压。随着产能释放，毛利率有望会有一个明显的修复。 **4、往三年维度展望，公司对未来的竞争是否有信心?** 答：半导体供应链认证在零部件行业属于技术高门槛级别，对于结构零部件来说其所属的附带工艺技术价值偏低会导致价格竞争激烈。而对洁净度、清洗度有超高要求的工艺零部件来说价格不是主要竞争因素。公司为了提高核心竞争力正积极扩充产能并加大技术研发投入，同时正逐步扩大模组业务并以平台化零部件生产为目标，提高自身技术实力和核心竞争力来应对市场竞争。 **5、扩产到产能释放的周期多少？** 答：产能释放周期因产品结构和工艺不同而有所差异。整条工艺链从土地建设到产品生产稳定交付需要一定周期。公司将根据客户需求分阶段扩产，结合产品结构扩充所需产品线，并提前做好人员储备和培训。项目进展相关情况请以公司定期报告及相关公告为准。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 19 日